

积层陶瓷电容器 新增着重翘曲裂纹对策的产品系列

- 保证基板弯曲 5mm，强度为标准规格的 2.5 倍

2014 年 4 月 24 日

TDK 株式会社（社长：上釜健宏）新增了积层陶瓷电容器的树脂电极产品系列，该系列着重了在基板封装后，由于分割基板等的压力造成的“翘曲裂纹”对策，并将从 2014 年 7 月起开始量产。

敝社至今为止一直以高结合可靠性产品为优势。为了在车载单元这种严酷的环境下能够更安全地使用积层陶瓷电容器，从而开发并量产了拥有金属端子的 MEGA CAP（迭容）产品及外部电极中内置有树脂的树脂电极产品。

这些产品拥有三大特点，并深受顾客好评。该三大特点是：在车载单元中因热循环所导致的“焊接裂纹”对策、因振动和冲击所导致的“元件损伤”对策、因基板变形所导致的“翘曲裂纹”对策。

敝社运用在此类车载用产品中培养的技术与技巧，采用有效缓解“翘曲裂纹”的发生原因亦即来自基板应力的外部电极构造，选择可有效缓解应力的树脂电极，并运用外部电极形成技术，成功地开发出了新系列树脂电极产品。

该系列产品与普通的端子电极构造产品规格相比，可以保证 2.5 倍的基板弯曲，在实际的普通基板处理作业中不会发生“翘曲裂纹”。

术语

- 翘曲裂纹：是指在将积层陶瓷电容器焊接到基板上后，由于插入印刷基板、插座、紧固螺丝、插入元件等作业而导致基板变形，因随之而产生的拉伸应力在积层陶瓷电容器的基础元件上产生裂纹的不良现象

主要应用

- 在处理基板（该基板焊接有使用于智能手机、PC、电源、电视机、游戏机、车载多媒体、基站等的积层陶瓷电容器）的操作中所必须的单元的“翘曲裂纹”对策或预防

主要特点与优势

- 有对策可对应已发生的“翘曲裂纹”
- 可能出现“翘曲裂纹”时的预防
- 保证基板弯曲 5mm（是标准规格的 2.5 倍）

主要特性

型号名	外形尺寸(L×W) [mm]	额定电压 [V]
1005(EIA 0402)	1.0x0.5	4~100
1608(EIA 0603)	1.6x0.8	4~100
2012(EIA 0805)	2.0x1.25	6.3~450
3216(EIA 1206)	3.2x1.6	6.3~2,000
3225(EIA 1210)	3.2x2.5	6.3~2,000
4532(EIA 1812)	4.5x3.2	6.3~2,000
5750(EIA 2220)	5.7x5.0	6.3~2,000
7563(EIA 3025)	7.5x6.3	16~50

*关于静电容量范围，支持和一般等级产品相同的广泛范围。

关于 TDK 公司

TDK 株式会社是一家领先的电子公司，总部位于日本东京。公司成立于 1935 年，主营铁氧体，是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK 的主要产品线包括 TDK 和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件，模块和系统产品*；电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK 以成为电子元件的领先企业为目标，重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2013 年度 3 月末，TDK 的销售总额约为 91 亿美元，全球雇员 80,000 人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。

请到本公司的新闻网站下载本新闻稿和相关图片

http://www.tdk.co.jp/news_center_c/press/201404241180.htm

地区媒体联系方式

地域	负责人	所属	电话号码	邮件地址
Greater China	Ms. Clover XU	TDK China Co., Ltd.	+86 21 61962307	pr@cn.tdk.com